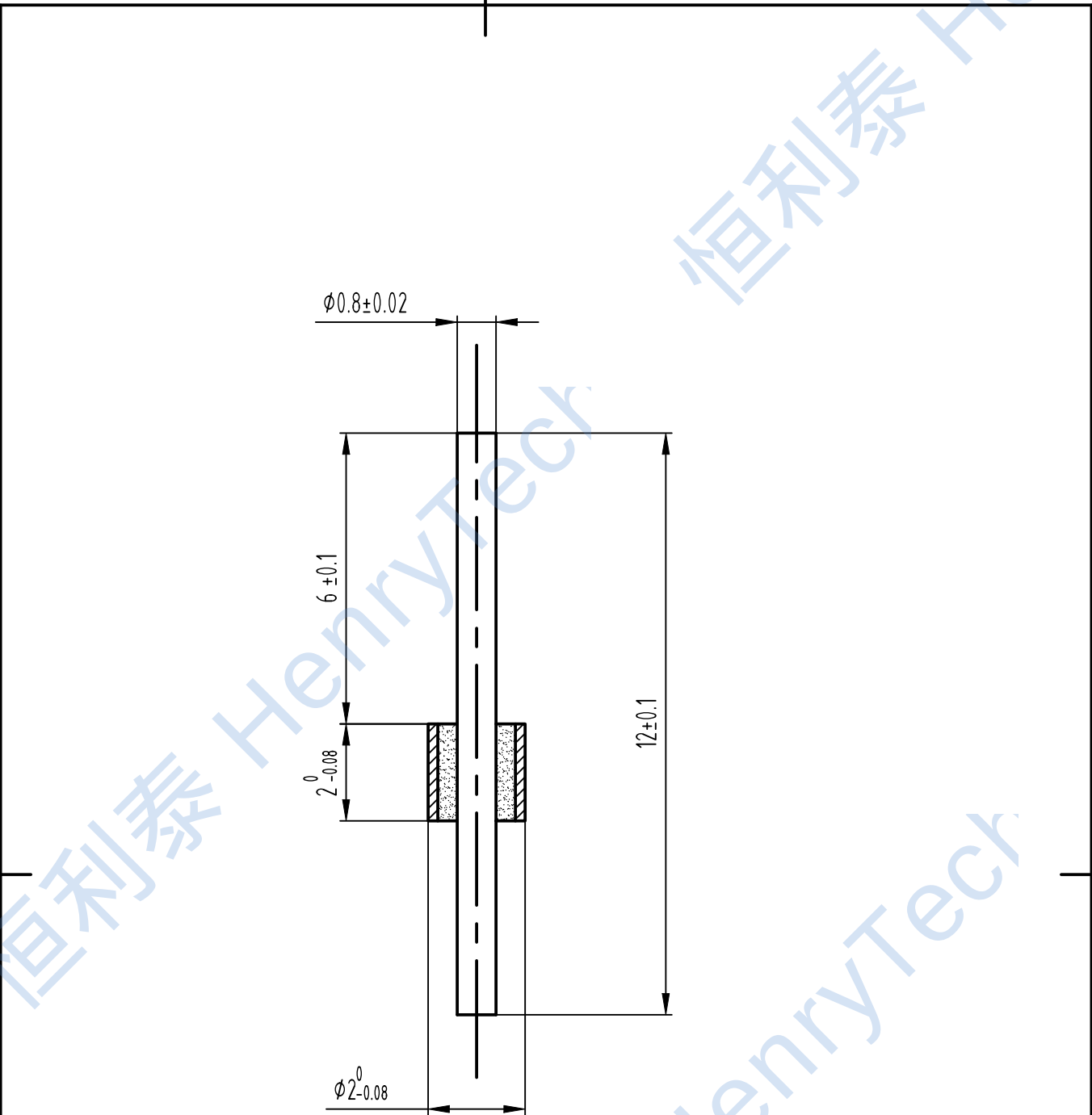




- 技术要求：
- 1. 绝缘电阻： $\geq 5000\text{M}\Omega @ 500\text{V}$
 - 2. 介电耐压： $\geq 300\text{V}$
 - 3. 密封漏率： $\leq 1.013 \times 10^{-3} \text{Pa} \cdot \text{cm}^3/\text{S}$
 - 4. 使用寿命： ≥ 500 次
 - 5. 温度范围： $-65 \sim +155$
 - 6. 镀层厚度： $\geq 1.27 \mu\text{m}$ 软金

借通用件登记										
	技术要求： 1. 绝缘电阻：≥ 5000MΩ@500V 2. 介电耐压：≥ 300V 3. 密封漏率：≤ 1.013x10 ⁻³ Pa · cm ³ /S 4. 使用寿命：≥ 500次 5. 温度范围：-65 ~+155 6. 镀层厚度：≥ 1.27 μm软金									
描 图										
校 描										
旧底图总号										
						装 配 图			HN-DC2020-0.8(12-6)M	
									成都恒利泰科技有限公司	
签 字										
	标记	处数	更改文件号	签字	日期	图 样 标 记			重 量	比 例
	设计	M		标准化						8:1
日 期										
	审核									
	工艺			日期		共 页			第 页	
 成都恒利泰科技有限公司 Chengdu HenryTech Technology co., Ltd										